下载日志已记录，仅供内部参考

通信

证券研究报告
2026 年 09 月 09 日

展会前瞻：AI+光电融合，CIOE 2026 直击产业风口

近日，作为光电行业重磅盛会，汇聚全球数千家光电企业的 CIOE 2026 发布多项预告，将围绕 AI 算力高速互联展开多项前瞻技术展示与产业论坛。论坛层面，大会配套举办 AI+新型光纤应用论坛，聚焦空芯光纤等特种光纤在 AIDC 的落地部署，推动云厂商、运营商与产业链企业协同选型。

产品端，多家国内龙头亮出下一代高速方案：光迅科技推出自研器件加持的 800G L Band 相干光模块，夯实产业链自主可控能力；华工正源首发 6.4T 无 DSP 低功耗 NPO 硅光光引擎，适配超大规模 AI 智算集群；LPAC 展示扇出型晶圆级封装光引擎，布局 NPO/CPO 先进封装赛道。制造装备环节，博众精工旗下企业首次展出 CPO/NPO 专用自动耦合设备、高精度固晶贴片机与整套智能制造方案。

整体来看，本届展会将集中验证从新型光纤、高速光模块、NPO/CPO 光引擎到核心制造设备的全产业链技术迭代节奏，是观察 AI 光互联技术路线落地进程的重要产业催化窗口。

本周投资观点：

我们认为，在整体宏观环境变化复杂背景下，把握核心高景气行业与资产是重要选择。我们仍坚定看好算力产业链核心标的的投资机会，AI 带动算力供应链核心标的有望实现较好的业务增长，重视产业链核心厂商。其中，海外算力产业链高景气度依旧，相关公司财报持续体现 AI 相关需求的高景气，相关产业链的基本面共振更强，我们持续看好海外算力产业链投资机会。国内方面，后续伴随着国产算力持续发展，大厂如阿里、字节等对于 AI 的持续投资，仍然看好 AI 行业以及围绕 AIDC 产业链的持续高景气。整体上我们积极看好 26 年国内 AI 基础设施需求延续高景气，同时应用有望持续开花结果。中美 AI 均进展不断，同时推理端持续推进。建议持续关注 AI 产业动态及 AI 应用的投资机会。

中长期我们建议持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会：海外线 AI 核心方向如光模块&光器件、液冷等领域值得重视，持续核心推荐；此外国产算力线如国产服务器，交换机，AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注。海风行业国内加速复苏，海外出海具备良好机遇，积极把握产业变化，核心推荐海缆龙头厂商。近期看到商业航天产业国内动态进展呈现，看好后续产业受催化拉动。

一、人工智能与数字经济：

1、**光模块**&光器件，**推荐：中际旭创、新易盛、天孚通信**、源杰科技（电子联合覆盖）；相关标的：东山精密、剑桥科技、长芯博创、仕佳光子、鼎通科技、光库科技、华懋科技（电新汽车团队联合覆盖）、致尚科技、罗博特科、中瓷电子、太辰光、德科立等。

2、**光纤光缆，推荐：亨通光电、中天科技、长飞光纤、永鼎股份**；相关标的：杭电股份、特发信息、通鼎互联等。

3、**交换机服务器 PCB**：推荐：**沪电股份（电子组联合覆盖）**、菲菱科思；**相关标的**：盛科通信、锐捷网络、胜宏科技、三旺通信、映翰通等。

4、**低估值、高分红，云和算力 idc 资源重估：中国移动、中国电信、中国联通。**

5、**AIDC&散热：**推荐：**英维克（机械联合覆盖）**、**润泽科技**（机械联合覆盖）、润建股份、**光环新网、科华数据**（电新联合覆盖）、奥飞数据（计算机联合覆盖）、**数据港**（计算机联合覆盖）。相关标的：大位科技、**申菱环境**（家电覆盖）、宏景科技、高澜股份、科创新源等。

6、**AIGC 应用/端侧算力**，推荐：**移远通信、广和通、美格智能**，相关标的：**彩讯股份、梦网科技、朗捷科技（电子组覆盖）**。

二、物联网&智能驾驶：

1、**出海复苏&头部集中，推荐：威胜信息（机械联合覆盖）、拓邦股份**（电子联合覆盖）、**亿联网络、广和通、美格智能**等，相关标的：**华测导航、和而泰（电子家电团队联合覆盖）**、移远通信、移为通信。

2、智能驾驶：相关标的：模组&终端（广和通、美格智能、移远通信、移为通信等）；传感器（汉威科技&四方光电-机械联合覆盖）；连接器（意华股份、鼎通科技等）；结构件&空气悬挂（瑞玛精密）等。

三、商业航天：

低轨卫星加速发展，低空经济积极推进，相关标的：**铖昌科技、华测导航**、盛路通信、信科移动、佳缘科技、盟升电子、中国卫通、**震有科技、通宇通讯**等。

其他细分领域标的：**中兴通讯、紫光股份（计算机联合覆盖）、亨通光电、中天科技、光迅科技、烽火通信、海格通信、上海瀚讯**、海能达、电科网安。

风险提示：AI 进展低于预期，下游应用推广不及预期，贸易摩擦等风险，报告中“相关标的”仅为对相关公司的罗列，不构成任何投资建议。

投资评级

行业评级	强于大市(维持评级)
上次评级	强于大市

作者

王奕红 分析师
SAC 执业证书编号：S1110517090004
wangyihong@tfzq.com

唐海清 分析师
SAC 执业证书编号：S1110517030002
tanghaiqing@tfzq.com

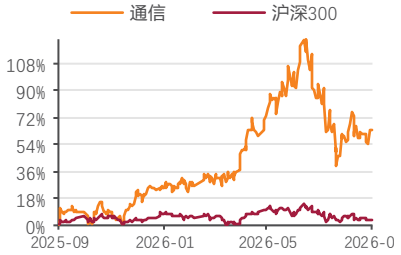
康志毅 分析师
SAC 执业证书编号：S1110522120002
kangzhiyi@tfzq.com

余芳沁 分析师
SAC 执业证书编号：S1110521080006
yufangqin@tfzq.com

袁昊 分析师
SAC 执业证书编号：S1110524050002
yuanhao@tfzq.com

王振铭 联系人
wangzhenming@tfzq.com

行业走势图



资料来源：聚源数据

相关报告

1 《通信-行业研究周报:光通信电芯片迎来行业扩容机遇，持续看好 AI 产业链景气度》2026-08-24

2 《通信-行业研究周报:国产超节点有望进入放量阶段，看好 AI 产业链持续快速发展》2026-08-17

3 《通信-行业研究周报:北美四大 CSP 云业务全线高增，算力订单与资本投入商业闭环或逐步建立》2026-08-04

下载日志已记录，仅供内部参考

重点标的推荐

股票代码	股票名称	收盘价（元）2026-09-09	投资评级	EPS(元) 2025A	2026E	2027E	2028E	P/E 2025A	2026E	2027E	2028E
300308.SZ	中际旭创	908.90	买入	9.72	24.47	52.75	74.91	93.51	37.14	17.23	12.13
300394.SZ	天孚通信	258.03	增持	2.59	3.69	7.37	11.03	99.63	69.93	35.01	23.39
300502.SZ	新易盛	414.80	买入	9.59	18.58	25.03	31.32	43.25	22.33	16.57	13.24
002463.SZ	沪电股份	127.55	增持	1.99	2.70	3.52		64.10	47.24	36.24	
600522.SH	中天科技	34.12	买入	0.94	1.20	1.47		36.30	28.43	23.21	
600487.SH	亨通光电	66.62	买入	1.09	3.49	4.34	5.03	61.12	19.09	15.35	13.24
688498.SH	源杰科技	1718.00	增持	2.22	7.15	10.22	14.93	773.87	240.28	168.10	115.07
000063.SZ	中兴通讯	33.09	增持	1.17	1.19	1.36	1.54	28.28	27.81	24.33	21.49
600941.SH	中国移动	97.11	买入	6.33	5.90	6.20	6.51	15.34	16.46	15.66	14.92
300442.SZ	润泽科技	62.40	买入	3.09	1.87	2.57	3.48	20.19	33.37	24.28	17.93
002139.SZ	拓邦股份	9.26	买入	0.29	0.41	0.56	0.65	31.93	22.59	16.54	14.25
688100.SH	威胜信息	25.46	买入	1.36	1.75	2.13	2.56	18.72	14.55	11.95	9.95
300628.SZ	亿联网络	39.94	买入	2.09	2.46	2.83		19.11	16.24	14.11	

资料来源：Wind，天风证券研究所

下载日志已记录，仅供内部参考

1. 展会前瞻：AI+光电融合，CIOE 2026 直击产业风口

光纤凭借超大带宽、超低时延等特性，已成为 AI 基建的核心传输介质，参与重塑智算中心架构，定义 AI 基础设施的极限。2026 年以来，空芯光纤、多芯光纤、保偏光纤等新型光纤、特种光纤产品，在智算中心的应用吸引了业界密切关注。光纤价格随着 AI 算力需求飙升而一路上涨；光纤厂商成为资本市场的关注热点；越来越多上市公司跨界进军光纤产业链。AI 带来了光纤产业新周期，业界期待把握全新的产业机遇。

鉴于此，C114 联合中国国际光电博览会（CIOE），将于 2026 年 9 月 11 日在深圳国际会展中心共同举办"AI+新型光纤应用论坛"。本次论坛以"光启智能 纤联未来"为主题，聚焦 AIDC 高密光互连、空芯光纤、G.654.E 干线部署、测试与运维四大核心议题，邀请来自中国信通院、三大运营商、互联网云厂商、垂直行业及资本市场的重量级嘉宾共聚一堂，旨在推动光纤光缆企业、云大厂、智算中心业主、运营商与资本方的技术与选型同频共振。

作为覆盖光电全产业链的综合型展会，CIOE 中国光博会汇聚了来自全球超 30 个国家和地区的超 4000 家的优质参展企业，超千家品牌新品发布，直击尖端技术风口。

光模块方面，光迅科技将在 CIOE 2026 期间进行 800G L Band OSFP ZR/ZR+相干模块的 Demo 演示，向行业展示最新的技术成果。作为国内首发产品，该模块的核心亮点在于搭载的光迅科技自研 L-Band 光器件：通过高功率小型化光学器件，在紧凑 OSFP 封装内实现 L-Band 出光功率优于 0 dBm，并具备稳定的规模化量产能力。这一突破不仅彰显了光迅科技在超高速相干光模块领域的技术实力，更为国内光通信产业链自主可控提供了有力支撑。

图 1：光迅科技 800G L band ZR/ZR+ 相干模块



资料来源：光纤在线公众号，天风证券研究所

NPO 产品方面，9 月 2 日华工正源（HGGenuine）发布预告，将在展会现场动态展出 6.4T NPO 光引擎。新推出的 6.4T NPO 方案，通过去 DSP 架构大幅降低整机功耗，精准适配 AI 算力与超大规模数据中心需求。

6.4T NPO 硅光光引擎亮点：

1、面向 AI 大模型时代，华工正源 6.4T NPO 硅光光引擎，兼容 IEEE 802.3dj 与 CMIS5.3 协议，去掉 DSP 芯片，实现功耗大幅降低；

2、采用 32 通道 212.5G PAM4 电气接口，单模光纤最远支持 500 米传输；配置 4 路 MPO16 收发接口，支持光接口定制化；

3、基于硅光技术开发，工作温度 0-70C°，可稳定服务于 AI 大模型训练集群、智算中心与超大规模云数据中心交换机，为高算力 AI 场景，提供高性能、低功耗的高速光互联解决方案。

下载日志已记录，仅供内部参考

图 2：华工正源 6.4T NPO 硅光光引擎示意图

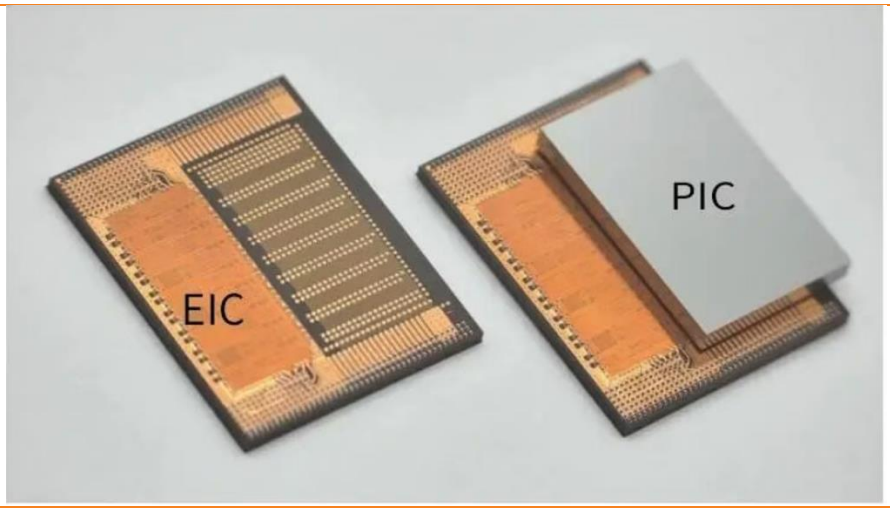


资料来源：光纤在线公众号，天风证券研究所

先进封装方面，LIPAC 将在展会上展出基于扇出型晶圆级封装（FOWLP）技术打造的新一代定制化 EIC/PIC 光引擎封装方案。

依托电/光集成电路（EIC&PIC）的定制化封装能力，LIPAC 同时面向传统可插拔光收发模块市场的高速需求，以及共封装光学（CPO）、近封装光学（NPO）下一代市场；二者是人工智能网络 scale-in、scale-up、scale-out、scale-across 扩容架构的核心。

图 3：采用 FOWLP 3D 封装技术的 LIPAC 1.6T-DR8 光引擎实物样品



资料来源：讯石光通讯公众号，天风证券研究所

此外，博众精工旗下中南鸿思将携 CPO/NPO 耦合机、全自动上下料双 FA 自动耦合机、全自动上下料双 Lens 自动耦合机、全自动上下料多通道多模 COB 自动耦合机等多款设备亮相展会。

其中，CPO/NPO 耦合机是中南鸿思本次参展的重磅新品，也是该设备在行业展会中的首次公开亮相。该设备专为 CPO（共封装光学）、NPO（近封装光学）光模块的 FA（光纤阵列）自动耦合、点胶固化工艺打造，直击 AI 算力集群对高速光互联的严苛制程需求。随着 800G/1.6T 光模块加速向 CPO 架构演进，高精度、高良率的自动耦合设备已成为产业链关键一环。中南鸿思此次推出的 CPO/NPO 耦合机，正是在这一技术拐点上的精准卡位。

图 4：中南鸿思 CPO/NPO 耦合机关键参数

下载日志已记录，仅供内部参考

参数	指标
设备型号	HS-CPOC-XX
运动轴数	12 轴
耦合系统	单 6 轴六自由度
行程范围	X ≥150mm，Y-Z ≥70mm，角度轴 ≥±4°
分辨率	25nm；0.003°
重复定位精度	±50nm；±0.003°
UV 固化	3 头，>1000mW/cm²，支持客户定制

资料来源：光纤在线公众号，天风证券研究所

除了 CPO/NPO 耦合机之外，本届展会中南鸿思还将展示全自动上下料双 FA 自动耦合机、全自动上下料双 Lens 自动耦合机、全自动上下料多通道多模 COB 自动耦合机等设备，进一步呈现其在光通信自动耦合领域的产品布局。

除中南鸿思之外，博众精工旗下博众半导体也将同期亮相。

作为半导体及光通信智能制造装备供应商，博众半导体持续围绕光通信核心制造环节进行布局。本届展会，博众半导体将重点展示高精度贴装设备以及光模块智能制造整体解决方案，覆盖芯片级精密制造、光电连接制造和光模块智能制造等应用方向。本次展会展品包括星威 EF8622 共晶贴片机及星威 EG9722 固晶贴片机等。

从芯片高精度贴装到 FA、Lens 及 COB 自动耦合，从关键单机设备到光模块智能制造整体解决方案，博众精工旗下中南鸿思与博众半导体将在 CIOE 2026 现场分别展示各自在光通信智能制造领域的产品与技术布局。

其中，中南鸿思将以 CPO/NPO 耦合机首次公开亮相为重点，集中展示自动光学耦合领域的新产品与技术能力；博众半导体则将围绕高精度贴装及光模块智能制造，为高速光互联制造带来更多自动化装备及解决方案。

下载日志已记录，仅供内部参考

2. 近期重点行业动态以及观点（8.31-9.5）

2.1. AI 行业动态

Anthropic 发新模型，OpenAI 同日预告新品将安全优先（来源：第一财经公众号）

当地时间 9 月 1 日，Anthropic 宣布推出 Claude Fable 5.1 和 Claude Mythos 5.1，并将其定位为世界上最先进的编程和知识工作模型。

略慢一步的 OpenAI 表示，最新模型 Astra 也将很快发布，但会将最先进的网络安全功能限于一小部分测试人员使用。Astra 是 OpenAI 指定的第一个达到其关键网络安全能力阈值的模型。

头部厂商同一时间窗口密集释放新模型信号，标志着短暂“熄火”后的前沿模型更迭竞争再次提速。而与以往单纯比拼基准测试分数不同，本轮竞赛的另一条主线逐渐清晰：随着模型能力逼近网络安全关键门槛，厂商正集体将安全部署从后台议题推向前台。

据第三方测评平台 Artificial Analysis 数据，Claude Fable 5.1 在人工智能分析智能指数中名列前茅。尽管缓存读取价格降低了 75%，但每次任务的成本仍比 Fable 5 高出 20%。

在前沿智能测试的各项基准中，Fable 5.1 均实现提升：智能指数方面比 Fable 5 提升了 4 分；在 HLE 测试中得分为 59.1%，超过了 Claude Fable 5 此前创下的 55.5%的最高分；在 Terminal-Bench v2.1（91.4%）和 SciCode（62.0%）测试中均取得该平台迄今为止见过的最高分；在 τ^3-Banking 测试中比 Fable 5 提升了 9 分。

价格层面，Anthropic 将缓存读取（命中）价格从每百万 token 1 美元大幅下调至 0.25 美元，降幅达 75%；标准定价则维持不变：输入每百万 token 10 美元、输出 50 美元、缓存写入 12.5 美元。这一调整将显著降低代理工作负载的成本。

紧跟 Claude Fable 5.1 和 Claude Mythos 5.1 之后，OpenAI 将更多表达倾斜在网络安全问题上。

OpenAI CEO 山姆·奥尔特曼表示，整个夏天，团队都全力推进安全方面的工作。如今，能力和安全保障措施的同步提升比以往任何时候都更加重要。他同时承认，新模型 Astra 的训练工作已完成一段时间，但后续型号根据需要放慢了进度，以确保能够充分开展安全性和适配性方面的工作。

官方称，Astra 已达到准备框架下的关键网络安全能力阈值，这意味着，在拥有合适的工具和访问权限的情况下，它可以发现此前未知的安全漏洞，并开发出在多个受保护系统中利用这些漏洞的方法，而无需人工指导每个步骤。这是 OpenAI 认定的首个达到此级别的模型，因此在开发过程中和发布前需要更严格的安全保障措施。

过去几周，OpenAI 推迟了 Astra 的部分开发和发布工作，以便加强和测试其针对网络滥用和未经授权的模型操作的防护措施。虽然 Astra 并未卷入此前的 Hugging Face 事件，但 OpenAI 表示已将该事件的经验教训融入安全策略，并为 Astra 实施了更严格的安全措施，包括训练模型更可靠地拒绝有害网络请求、增加防止滥用的保护措施以及监控以阻止潜在的未经授权的活动。

Anthropic 同样在加大安全建设投入。据官方披露，该公司正在对近期两起安全事件进行深入分析，并计划与 METR 合作进行独立审查，希望确保两项调查全面彻底，并将在未来几周内公布更多信息。

一颗完全由 AI 设计的芯片，全球首款！（来源：半导体行业观察公众号）

日前，由 Ebrahim Hussain 和 Aaditya Subedi 领导的定制芯片人工智能研究实验室 Architect Labs 宣布，其人工智能系统根据人工编写的规范生成并完全验证了端到端的、可用于生产的人工智能加速器 Redwood。

下载日志已记录，仅供内部参考

仅由两位人类架构师提供技术规范，人工智能系统就在不到两周的时间内完成了芯片的设计和全面验证。它还参与了固件和定制内核的设计，并将现代人工智能模型映射到硬件上。最终的加速器目前运行在 FPGA 平台上，对包括 Llama 和 Qwen 在内的数十亿参数模型进行推理。

性能测试结果也表明，Redwood 不仅仅是概念验证。基于三星的 8nm 工艺，Redwood 的吞吐量是 NVIDIA Jetson Orin Nano 的 1.75 倍，功耗却降低了 1.9 倍，这意味着在相同的 AI 模型下，其每瓦性能提升了 3.4 倍。

芯片设计可能需要数年时间和数亿美元，而专业人才的日益匮乏使得先进半导体研发集中在少数几家大型公司手中。因此，人工智能工作负载往往需要适配远在最新型号问世之前设计的硬件。

Redwood 采取了不同的方法，从一开始就将硬件和软件进行协同设计。内核、固件和 RTL 代码共同开发和优化，使芯片能够根据 AI 工作负载进行定制，而不是强迫软件去适应现有的硬件。

这形成了一个持续的反馈循环，改进的 AI 模型可以为更好的硬件设计提供信息，而更高效的硬件可以实现更好的 AI 性能，从而有可能加速开发周期的两端。

AI 办公智能体开始抢占硬件入口（来源：第一财经公众号）

AI 办公智能体的竞争已延伸到硬件领域。

9 月 2 日，腾讯 WorkBuddy 上线开放平台，首批引入超百家生态伙伴，面向智能硬件、行业应用与开发者等开放底层 Agent（智能体）能力。这是国内 AI 智能体赛道首个同时打通硬件、应用与开发者三层生态的开放平台。

WorkBuddy 的智能硬件合作方包括 Plaud、Rokid、影石、科大讯飞、安克、猛玛、京东京造等，有 9 款联名智能硬件在发布会上亮相。以智能眼镜为例，据腾讯介绍，眼镜端的麦克风与摄像头负责采集，WorkBuddy 负责理解、规划与执行，软硬件配合可用于会议纪要、记忆检索等。WorkBuddy 还接入了录音卡、麦克风、耳机等。

腾讯 WorkBuddy 开放生态负责人林佐露表示，Agent 已跨过“能做事”这道坎。但对开发者和企业而言，Agent 化门槛和成本仍偏高。当前的挑战是如何让 Agent 在任何设备、系统、场景里都不中断，这需要打通生态上下文。

此前用户在 WorkBuddy 上的付费方式包括购买套餐，套餐包含积分。WorkBuddy 与硬件厂商的合作中，变现方式则未完全定型。据林佐露介绍，团队正在开发经营工具，以支撑合作伙伴的经营需求。

一名硬件合作厂商业务负责人指出，后续可能涉及硬件厂商与 AI 办公智能体厂商之间的服务采购，用户可能直接从硬件厂商购买服务。除了 WorkBuddy，该公司未来也考虑接入更多智能体。

除了打通多款硬件，WorkBuddy 还推出“Buddy 应用”入口，供合作商根据业务场景、上下文等构建 Agent 办公产品。

就接入 AI 办公智能体能力后的相关定价和分成问题，帆软软件有限公司沈涛表示，2015 年前后出现的企业协同平台用了大约三四年时间进行市场教育，WorkBuddy 及同品类产品目前也仍处于教育用户的阶段，就他目前的考虑，正式谈用户付费是下一阶段的事。

AI 办公领域已有多家互联网大厂的身影。

7 月底，阿里整合了 QoderWork、悟空、MuleRun 三款智能体的新产品“千问办公”开始小范围测试，字节跳动也整合了飞书产品团队与豆包产品团队。两家厂商在 AI 办公领域“集中兵力”。

据易观分析数据，6 月中国桌面端 AI 原生办公智能体平台中，WorkBuddy 月访问量 2097

下载日志已记录，仅供内部参考

万次，排名第一，字节跳动旗下 TRAE IDE（国内版）排名第二。AI 产品榜 7 月 AI 办公智能体桌面端数据则显示，WorkBuddy、百度搭子月活排名前二。

2.2. 光通信行业动态

国科光芯完成数亿元 B+轮融资，加速 PIC 量产及布局下一代硅光芯片赛道（来源：讯石光通讯公众号）

ICC 讯 近日，国科光芯（海宁）科技股份有限公司（以下简称"国科光芯"）宣布完成数亿元人民币 B+轮融资。本轮融资由四川省科创投资集团领投，杭州凯泰资本、山东省科创集团等机构跟投，充分彰显了资本市场对硅光芯片赛道及国科光芯核心技术价值的高度认可。

本轮募集资金将重点用于下一代单波 400Gbps 硅光芯片、1.6T/3.2T 硅光探测器芯片、3.2T/6.4T NPO/CPO、OIO 芯粒等新产品开发、数通子公司（子品牌：星汉光子）的扩产投入以及海外交付中心的建设规划，为公司在 AI 算力光互连浪潮中的规模化增长奠定坚实基础。

AI 驱动光互连代际跃迁，硅光进入黄金发展期

当前，以大模型为代表的生成式 AI 正推动全球算力基础设施进入规模化扩张期。AI 集群对跨芯片、跨节点、跨机柜的高速互联提出了前所未有的带宽与功耗要求，光模块正加速从 800G 向 1.6T 乃至 3.2T 代际演进，传统分立光器件方案在集成度、功耗、成本与量产一致性上均已逼近物理极限。

以氮化硅为代表的新一代硅光材料平台，凭借超低传输损耗、超高光学功率承载能力与 CMOS 工艺兼容性，成为突破上述瓶颈的关键路径。业内普遍认为，谁能在高性能硅光集成芯片（PIC）上率先实现量产验证，谁就掌握了下一代光互连的核心话语权。

面向 AI 算力基础设施向 3.2T 代际演进的趋势，国科光芯已完成前瞻性技术与产能布局。本轮融资资金将聚焦三大战略方向：

其一，加速下一代产品矩阵研发。公司将全力推进单波 400Gbps 硅光芯片，1.6T/3.2T 硅光探测器芯片、3.2T/6.4T NPO/CPO、OIO 芯粒等新产品的开发，构建覆盖"发射—接收—共封装"的完整硅光芯片产品矩阵，抢占 3.2T 代际技术制高点，并深度参与 CPO/OIO 等下一代光互连架构的产业生态建设。

其二，扩产成都数通基地。公司将持续加大成都数通子公司（子品牌：星汉光子）的扩产投入，扩充晶圆产能与测试能力，打造面向数通市场的规模化量产基地，为 AI 数据中心客户的高速增长需求提供充足的产能保障。

其三，策划建设海外交付中心。面对全球 AI 算力客户日益增长的就近交付与快速响应需求，公司将建设海外交付中心，构建本地化的技术支持、测试验证与供应链协同能力，全面提升全球客户的交付确定性，加速国际化战略落地。

通过"总部研发+成都量产+海外交付"的三位一体布局，国科光芯将实现从芯片研发到全球规模化月百万级芯片产能交付的完整闭环。

本轮融资领投方四川省科创投资集团表示："光互连是 AI 算力基础设施的核心瓶颈环节，硅光芯片则是光互连的技术制高点。国科光芯团队深耕硅光领域超过 15 年，公司 400G/800G/1.6T 产品的批量出货验证了其技术领先性与工程化能力，我们坚定看好公司成为全球硅光芯片领域的领军企业。AI 集群的规模化建设正推动光互连向 1.6T、3.2T 快速演进，硅光渗透率迎来历史性拐点。国科光芯在性能、良率、功耗等关键指标上均已跻身行业第一梯队，且前瞻布局了 CPO/OIO 等下一代技术路线。我们期待与公司携手，共同见证中国硅光芯片走向全球。"

下载日志已记录，仅供内部参考

英思嘉推出业界首款 250μm 间距硅光套片：NPO 产品矩阵进一步完善，持续提升核心竞争力（来源：光纤在线公众号）

9/04/2026，光纤在线讯，英思嘉半导体今日宣布，推出业界首款 250μm 通道间距、采用倒装（Flip-Chip）设计的激光驱动器芯片（ISG-D5682）和 TIA（ISG-T5780）套片，适用于 100G/Lane 应用，进一步丰富了其全国产化 NPO 硅光产品系列。此前，英思嘉四通道 375μm NPO 硅光套片（ISG-D5680、 ISG-T5783）已实现量产。该套片的发布标志着英思嘉 NPO 产品矩阵的又一次重要扩充，持续增强国产高端电芯片核心竞争力。

此次发布的英思嘉 NPO 硅光套片方案专为 AI 数据中心短距光互连应用设计，能够更好地满足 NPO 应用对高集成度与高性能的严苛要求。该套片包含两颗八通道芯片，每通道最高支持 53Gbaud/s 速率，通道间距仅为 250μm，是业界尺寸最紧凑的八通道 53Gbaud/s MZ 驱动器和 TIA 套片之一。更紧凑的通道间距带来了更高的集成密度，在 16 通道 3.2T NPO 应用设计下，同时使用两片 ISG-D5682，所占布板尺寸空间仅为 5.321*2.66mm，为 NPO/CPO 应用场景下持续提升的高密度需求，提供了高度紧凑的解决方案。

得益于驱动器输入侧集成 AC 电容的倒装设计，该套片可通过凸点直接焊接到 PCB 基板上，能有效提升组装良率与布板灵活性。ISG-D5682 MZ 驱动器集成了英思嘉获得发明专利的硅光控制功能，可根据 MPD 电流自动调整 Heater 电流，精准设置调制器偏置点；同时提供可调节的低频和高频均衡功能，以补偿 PCB 及主机侧插损；还集成了获得发明专利的自动增益控制（AGC）功能，确保在输入摆幅波动时输出摆幅保持恒定。ISG-T5780 线性 TIA 则提供 RSSI 与带宽可调功能，输出幅度高达 500mVpp，充分满足高性能光互连的严苛要求。

在应用层面，该套片适用于对集成度有严苛要求的 800G 高密度光引擎、3.2T NPO 方案及 CPO 方案。ISG-D5682 与 ISG-T5780 从芯片架构设计、晶圆流片制造、晶圆性能测试到成品可靠性验证，全链条所有环节均在中国大陆本土完成，实现了完整的国产化闭环。依托国内成熟的流片工艺体系与自有晶圆测试产线，英思嘉有效降低了对海外供应链的依赖，从根源上规避了海外技术封锁、供货受限、交付延迟等风险，全面保障了产品产能稳定、高效交付与供应链安全。

此次发布是英思嘉 NPO 产品系列的又一次重要扩充。此前，英思嘉已成功量产 ISG-D5680 与 ISG-T5783 硅光 NPO 套片，并已推出 ISG-D5688 与 ISG-T5788 VCSEL NPO 套片。ISG-D5682 与 ISG-T5780 的加入，使英思嘉 NPO 系列产品线更加完善，覆盖了从 250μm 到 625μm 的通道间距、从 VCSEL 到硅光的多维技术路线。针对更高速的 3.2T 及 6.4T NPO 应用，英思嘉也已布局单波 200G 速率的套片方案，为客户提供更丰富、更灵活的 NPO 产品选择。

莱塔思发布先进 ELSFP 连接器，解决 CPO 外置激光器连接痛点（来源：讯石光通讯公众号）

人工智能时代，光纤通信系统的一个大热点是 CPO 交换机，它比可插拔光模块有若干更好的性能。CPO 的发光由可插拔 ELSFP 外置激光器光模块提供，通过单模保偏光纤送入 CPO 系统内部。由于是可插拔光模块，激光器坏了可以迅速替换。ELSFP 光模块有光纤连接器接口，需要 ELSFP 光纤连接器。这个连接器比起普通光纤连接器难得多，需要满足两个苛刻的条件：1）盲插。2）高功率（450 毫瓦到 [illegible] 毫瓦）。ELSFP 光纤连接器已经形成了国际标准，但是顾客反馈市场领先公司的现有产品有两大问题：1、插拔重复性非常不好，重复插拔时插损变化量可达 0.8dB；2、高功率的激光经常烧坏光纤端面。

莱塔思隆重发布 ELSFP 光纤连接器，基于莱塔思发明的先进机械设计工作原理（专利已提交）。第一，具有 2 级对准的光纤连接器结构，第二，插芯带有预松弛，不容易撞花光纤端面。

莱塔思的 ELSFP 已经研发成功。经过多轮测试，重复插拔时插损变化量小于 0.04dB。比现有同类产品的插损变化量小一个数量级以上。烧光纤端面的几率也达到最优。

下载日志已记录，仅供内部参考

3. 本周行业投资观点

本周投资观点：

在整体宏观环境变化复杂背景下，把握核心高景气行业与资产是重要选择。我们仍坚定看好算力产业链核心标的的投资机会，AI 带动算力供应链核心标的有望实现较好的业务增长，重视产业链核心厂商。其中，海外算力产业链高景气度依旧，相关公司财报持续体现 AI 相关需求的高景气，相关产业链的基本面共振更强，我们持续看好海外算力产业链投资机会。国内方面，后续伴随着国产算力持续发展，大厂如阿里、字节等对于 AI 的持续投资，仍然看好 AI 行业以及围绕 AIDC 产业链的持续高景气。整体上我们积极看好 26 年国内 AI 基础设施需求延续高景气，同时应用有望持续开花结果。中美 AI 均进展不断，同时推理端持续推进。建议持续关注 AI 产业动态及 AI 应用的投资机会。

我们建议持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会：海外线 AI 核心方向如光模块&光器件、液冷等领域值得重视，持续核心推荐；此外国产算力线如国产服务器，交换机，AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注。海风行业国内加速复苏，海外出海具备良好机遇，积极把握产业变化，核心推荐海缆龙头厂商。近期看到商业航天产业国内动态进展呈现，看好后续产业受催化拉动。

中长期我们持续推荐 AI 算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向：1）AI 和数字经济仍为强主线，未来需要紧抓核心受益标的：ICT 设备、光模块/光芯片、PCB、IDC/液冷散热、GPT 应用、电信运营商（数字经济+工业互联网）等相关公司都有望迎来新机遇。2）商业航天&“天地一体化”为 6G 重点方向，建议关注通导遥各细分赛道。3）海风未来几年持续高景气，海缆壁垒高&格局好&估值低，投资机会凸显。

人工智能&数字经济是未来产业长期大趋势：算力+网络+存储+散热为主要受益方向，AI 新科技浪潮将持续拉动 ICT 设备商、光通信、PCB、散热温控等需求，长期重视其相关投资机会；

以满足流量增长为目标的有线网络扩容：随着 5G 用户渗透，网络流量快速提升，光传输、光模块等扩容升级迫在眉睫；

以满足应用和内容增长需求的云计算基础设施和物联网硬件终端投资：ISP 厂商基于新应用和新内容增长，加大云计算基础设施投入，包括 IDC、网络路由交换、服务器、配套温控电源、光模块及光器件的新一轮景气提升。

双碳长期目标下，重点关注通信+新能源，另外应用端，云视频、数据、物联网/智能汽车、工业互联网、商业航天等行业应用进入加速发展阶段，中长期成长逻辑清晰，进入重点关注阶段。

具体细分行业来看：

一、人工智能与数字经济：

1、光模块&光器件，**推荐：中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技（电子联合覆盖）；相关标的：东山精密、剑桥科技、长芯博创、仕佳光子、鼎通科技**、光库科技、**华懋科技（电新汽车团队联合覆盖）**、致尚科技、罗博特科、中瓷电子、太辰光、德科立等。

2、光纤光缆，**推荐：亨通光电、中天科技、长飞光纤、永鼎股份**；相关标的：杭电股份、特发信息、通鼎互联等。

3、交换机服务器 PCB：推荐：**沪电股份（电子组联合覆盖）、菲菱科思；相关标的：盛科通信、锐捷网络、胜宏科技**、三旺通信、映翰通等。

4、低估值、高分红，云和算力 idc 资源重估：**中国移动、中国电信、中国联通**。

下载日志已记录，仅供内部参考

5、AIDC&散热：推荐：**英维克（机械联合覆盖）、润泽科技（机械联合覆盖）、润建股份、光环新网、科华数据（电新联合覆盖）、奥飞数据（计算机联合覆盖）**、数据港（计算机联合覆盖）。相关标的：**大位科技**、申菱环境（家电覆盖）、宏景科技、高澜股份、科创新源等。

6、AIGC 应用/端侧算力，推荐：**移远通信、广和通、美格智能**，相关标的：**彩讯股份、梦网科技**、翱捷科技（电子团队覆盖）。

二、物联网&智能驾驶：

1、出海复苏&头部集中，推荐：**威胜信息（机械联合覆盖）、拓邦股份（电子联合覆盖）、亿联网络**、广和通、美格智能等，相关标的：**华测导航、和而泰（电子家电团队联合覆盖）、移远通信**、移为通信。

2、智能驾驶：相关标的：模组&终端（广和通、美格智能、移远通信、移为通信等）；传感器（汉威科技&四方光电-机械联合覆盖）；连接器（意华股份、鼎通科技等）；结构件&空气悬挂（瑞玛精密）等。

三、商业航天：

低轨卫星加速发展，低空经济积极推进，相关标的：**铖昌科技、华测导航**、盛路通信、信科移动、佳缘科技、盟升电子、中国卫通、**震有科技、通宇通讯等**。

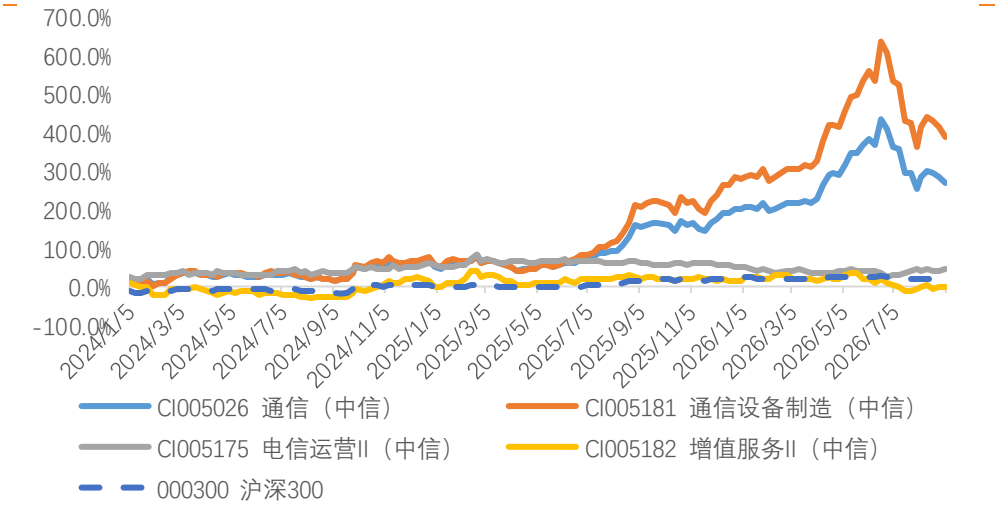
其他细分领域标的：**中兴通讯、紫光股份（计算机联合覆盖）、亨通光电、中天科技、光迅科技、烽火通信、海格通信、上海瀚讯**、海能达、电科网安。

4. 板块表现回顾

4.1. 本周（08.31-09.04）通信板块走势

本周（08.31-09.04）通信板块下跌 4.10%，跑输沪深 300 指数 2.77 个百分点，跑输创业板指数 0.07 个百分点。其中通信设备制造下跌 4.76%，增值服务上涨 1.81%，电信运营上涨 1.23%，同期沪深 300 下跌 1.33%，创业板指数下跌 4.03%。

图 3：本周（08.31-09.04）板块涨跌幅



资料来源：Wind，天风证券研究所

4.2. 本周市场个股表现

下载日志已记录，仅供内部参考

本周通信板块涨幅靠前的个股有恒宝股份、楚天龙、ST 恒信；跌幅靠前的个股有泰晶科技、东土科技、太辰光。

表 1：本周（08.31-09.04）通信板块个股涨跌幅前十

涨幅前十			跌幅前十		
证券代码	证券简称	周涨幅（%）	证券代码	证券简称	周涨幅（%）
002104	恒宝股份	20.50%	002902	铭普光磁	-9.59%
003040	楚天龙	14.16%	300620	光库科技	-9.98%
300081	ST 恒信	11.25%	688800	瑞可达	-10.11%
603236	移远通信	10.94%	003031	中瓷电子	-10.16%
603559	中通国脉	10.33%	601869	长飞光纤	-10.31%
688205	德科立	10.10%	603679	华体科技	-10.41%
300578	会畅科技	9.63%	301205	联特科技	-11.17%
300025	华星创业	8.70%	300570	太辰光	-11.89%
603322	超讯科技	7.61%	300353	东土科技	-11.99%
300852	四会富仕	6.41%	603738	泰晶科技	-14.72%

资料来源：Wind，天风证券研究所

5. 下周（09.07-09.11）上市公司重点公告提醒

表 2：下周（09.07-09.11）通信板块上市公司重点公告提醒

星期	日期	公司	事件
周一	9 月 7 日	世纪鼎利、新天科技、新易盛、三峡新材	股东大会召开
周二	9 月 8 日	爱施德、华阳集团、亿联网络、广哈通信、华脉科技	股东大会召开
		通宇通讯	限售股份上市流通
		剑桥科技	分红派息
		剑桥科技	分红除权
周三	9 月 9 日	中瓷电子、道通科技	股东大会召开
		视源股份	分红派息
		视源股份	分红除权
周四	9 月 10 日	拓邦股份、通宇通讯、南凌科技、长江通信、瑞可达	股东大会召开
		中国电信	分红除权
		中国电信	分红派息
周五	9 月 11 日	高德红外、普天科技、平治信息、波导股份、*ST 实达、长飞光纤、映翰通、ST 臻镭	股东大会召开
		中瓷电子	限售股份上市流通

资料来源：Wind，天风证券研究所

6. 重要股东增减持

表 3：本周公告通信股重要股东增减持

名称	变动截止日期	股东类型	方向	变动数量(万股)	占总股本比例(%)	交易平均价（元）	9 月 4 日收盘价（元）	周内股价变动
有方科技	2026-08-31	高管	减持	0.7087	0.008%	35.35	34.80	5.65%
有方科技	2026-09-02	高管	减持	2.1263	0.023%	35.43	34.80	5.65%
信科移动-U	2026-08-28	高管	增持	0.5000	0.000%	13.23	12.50	-4.29%
锐科激光	2026-09-03	高管	增持	0.3000	0.001%	36.80	38.69	2.95%

下载日志已记录，仅供内部参考

三维通信	2026-08-28	高管	减持	83.3000	0.103%	10.67	10.75	1.13%
三维通信	2026-08-31	高管	减持	117.0000	0.145%	10.65	10.75	1.13%
菲利华	2026-08-31	高管	减持	1.0000	0.002%	95.21	89.31	-0.53%
菲利华	2026-09-02	高管	减持	1.0000	0.002%	94.10	89.31	-0.53%
菲利华	2026-09-03	高管	减持	11.0000	0.021%	92.48	89.31	-0.53%
世嘉科技	2026-08-28	高管	减持	5.0000	0.020%	30.26	28.45	-4.21%
世嘉科技	2026-08-28	高管	减持	5.0000	0.020%	30.00	28.45	-4.21%
中光防雷	2026-09-01	高管	减持	3.3800	0.010%	11.00	11.13	3.53%
中光防雷	2026-09-02	高管	减持	14.0000	0.043%	11.52	11.13	3.53%
神宇股份	2026-08-28	高管	减持	0.3000	0.002%	25.14	23.16	-5.93%
神宇股份	2026-08-31	高管	减持	3.5000	0.019%	25.20	23.16	-5.93%
神宇股份	2026-08-31	高管	减持	1.9000	0.010%	25.22	23.16	-5.93%
神宇股份	2026-09-01	高管	减持	3.3600	0.018%	25.37	23.16	-5.93%
神宇股份	2026-09-01	高管	减持	3.1000	0.017%	25.71	23.16	-5.93%
神宇股份	2026-09-02	高管	减持	0.5000	0.003%	27.00	23.16	-5.93%
神宇股份	2026-09-02	高管	减持	1.1400	0.006%	26.45	23.16	-5.93%
光庭信息	2026-08-31	高管	减持	1.6200	0.012%	28.89	28.31	-0.21%
光庭信息	2026-09-01	高管	减持	0.4800	0.004%	29.00	28.31	-0.21%

资料来源：Wind，天风证券研究所

7. 限售解禁

未来三个月限售解禁通信股共 10 家，解禁股份数量占总股本比例超过 15%的公司有中瓷电子、信科移动-U、康希通信。

表 4：未来三个月通信股限售解禁

公司名称	解禁日期	解禁数量(万股)	占总股本比	9 月 4 日收盘价（元）	解禁股市价（万元）	解禁股份类型
通宇通讯	2026-09-08	115.25	0.22%	30.44	3,508.21	股权激励限售股份
中瓷电子	2026-09-11	11,089.62	24.59%	113.78	1,261,776.54	定向增发机构配售股份
盛科通信-U	2026-09-14	604.69	1.47%	324.80	196,402.76	首发战略配售股份
信科移动-U	2026-09-28	140,197.28	41.01%	12.50	1,752,466.00	首发原股东限售股份
广哈通信	2026-09-30	3,126.30	11.15%	18.13	56,679.87	定向增发机构配售股份
长盈通	2026-10-13	640.64	4.97%	163.00	104,423.93	定向增发机构配售股份
九联科技	2026-10-19	2,195.29	4.21%	8.81	19,340.50	定向增发机构配售股份
康希通信	2026-11-17	10,806.84	25.46%	13.47	145,568.14	首发原股东限售股份
金信诺	2026-11-30	2,206.01	3.22%	11.97	26,405.96	定向增发机构配售股份
菲利华	2026-12-01	345.94	0.66%	89.31	30,895.98	定向增发机构配售股份

资料来源：Wind，天风证券研究所

下载日志已记录，仅供内部参考

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。
本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。
本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。
天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益-10%-10%
		卖出	预期股价相对收益-10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅-5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅-5%以下

天风证券研究

北京	海口	上海	深圳
北京市西城区德胜国际中心 B 座 11 层	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 A 栋 23 层 2301 房	上海市虹口区东长治路 855 号北外滩金茂中心 T1 栋 19 楼	深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 22 层
邮编：100088	邮编：570102	邮编：200082	邮编：518028
邮箱：research@tfzq.com	电话：(0898)-65365390	电话：(8621)-60256006	电话：(86755)-23915663
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com